

個人投資家向け会社説明会 ミーティングメモ

ダイトロン株式会社(7609)

開催日：2025年3月1日（土）

場所：オービック御堂筋ビル2階 オービックホール（大阪府大阪市中央区）

説明者：代表取締役社長 土屋 伸介 氏

1. 会社概要及び事業内容

- ・ 設立は1952年6月24日。本社は大阪です。現在、従業員は約1,000名。事業内容は、電子機器及び部品、各種製造装置の製造と販売、輸出入を行っています。
- ・ 企業理念は、「創業の精神」と「行動規範」、「経営理念」の3つを軸としています。中でも「創業の精神」の「きびしい仕事、ゆたかな生活」は、創業者の高本善四郎氏が考えたものです。現在も社内で浸透しており、若い社員もこの言葉をしっかり理解し、一生懸命仕事に励んでいます。また「行動規範」をベースに、事業を展開しています。
- ・ 私どもは海外にもグループ会社があります。グループ会社に向けたメッセージとして、「Creator for the NEXT (クリエイター・フォー・ザ・ネクスト)」というグループステートメントを定めています。対外的なメッセージでは、「グローバルな観点で市場を捉え、お客様のニーズの一步先の価値を創造し、提供する」を掲げ、取り組んでいます。
- ・ 社名の由来について。1952年の設立当初は大都商事という社名の商社でした。京都府出身の創業者の高本善四郎氏が大阪で会社を起こしました。大阪の「大」と出身地の京都の「都」を取って、大都商事としました。
その後1998年の上場を機に、「ダイトエレクトロン」という社名に変更いたしました。さらにその後、私どもの国内の生産子会社2社と、商社の母体であるダイトエレクトロンが統合し、2017年にダイトロンという今の社名になっています。
- ・ 創業から現在までの売上高の推移について。1950年代から60年代はまさに創業期。その後、創業者の考えもあり、単に商社だけではなく、技術やものづくりを意識し始めます。商社機能だけでなく、生産も一緒に育てていこうという気運が高まり、製販一体路線を形成。1970年代から90年代の間に製造子会社を作っています。
1990年代までは国内中心に、製造と販売を一体化したモデルをしっかりと展開してきましたが、2000年代に入ると、もっと成長したいという意識が高まります。そこで市場を国内だけでなく海外にも目を向けようということになりました。
そのベースとなるのが製販一体、今は製販融合とも言いますが、この機能をベースにグローバル展開を図るのが、2000年代から今に至る流れです。
その間に店頭公開し、東証一部に上場しました。昨年過去最高の売上と利益を更新することができました。
- ・ 営業拠点と生産拠点について。国内は23拠点。そのうち6拠点は工場関係です。大阪本社を中心に、東京、名古屋、北は仙台、南は熊本まで営業所と工場を構えています。

大和インベスター・リレーションズ(株)（以下、「当社」といいます。）はこの資料の正確性、完全性を保証するものではありません。ここに記載された意見等は当社が開催する個人投資家向け会社説明会の開催時点における当該会社側の判断を示すに過ぎず、今後予告なく変更されることがあります。当社は、ここに記載された意見等に関して、お客様の銘柄の選択・投資に対して何らの責任を負うものではありません。この資料は投資勧誘を意図するものではありません。当社の承諾なくこの資料の複製または転載を行わないようお願いいたします。

海外は 14 拠点あります。うち 1 つは工場を持っています。工場はアメリカの真ん中のネブラスカ州にあります。それ以外の拠点は販売や技術サービスを行う拠点です。東南アジア中心にアジア全般と、ヨーロッパにも一昨年、オランダに現地法人を設立しています。アメリカには工場以外にオレゴン州にアメリカ本社という位置付けで、販売や色々な技術・サービスの拠点があります。このように世界の市場をカバーできる体制ができています。

- ビジネスモデルと強みについて、当社には製販融合の強みがあります。商社機能のマーケティング力とメーカー機能の技術力。技術力には設計と自社開発力、製造・生産能力が含まれますが、マーケティング力と技術力を合わせた機能を持っていることが私どもの強みです。また、このビジネスモデルで今後も成長が期待できると考えています。
- 組織体制は、2 つの本部と 2 つのカンパニーで構成されています。

M&S カンパニーは元々の商社の部分を引き継ぐ商社機能を持つ部門です。もう 1 つの D&P カンパニーは製造機能を持つ部門で、設計も開発も行います。D&P カンパニーは、1 つが部品関係、もう 1 つが装置関係の事業を運営しています。

2 つの本部のうちの 1 つは海外事業本部です。海外市場での販売、輸出入、海外のグループ関連会社の管理を行っています。海外事業本部自体のスタッフは約 60 名ですが、海外拠点のスタッフは 270 名で、合計約 330 名にて海外事業を司っています。

もう 1 つは管理本部です。ここは比較的少数精鋭の部門で現在 80 名ほどです。M&S カンパニーと D&P カンパニー、それから海外関係を管理・サポートし、さらに人事関係をサポートしています。

【セグメント別の売上構成比・取扱商品・用途】

- 商品セグメント別の売上高構成比については、私どもの売上の約 70%が電子機器及び部品のセグメントです。残りが製造装置関係と新規事業のセグメントです。新規事業は、データセンター向け UPS（無停電電源装置）のビジネスを展開しています。

さらに電子機器及び部品の中にもいくつかのセグメントがあります。画像機器、電子部品&アセンブリ、エンベデッド、半導体等々です。

製造装置でも、電子部品製造装置と半導体・FPD 製造装置に分かれています。

- セグメント別の取扱商品について、まず電子機器及び部品セグメントでは、電子部品&アセンブリ商品が比較的大きな比率を占めています。これはコネクタや電線ケーブル関係やハーネスなどとも言われておりますが、コネクタでは私どものオリジナル製品としてハーメチックコネクタを生産しています。これは非常に密閉性が高く技術を要するコネクタで、ニッチな市場で求められています。このような特別なコネクタを生産しています。

エンベデッドシステムでは、産業用カスタム PC や産業装置用組込 PC を扱っています。

電源機器では、超低ノイズスイッチング電源を私どものオリジナル製品として生産し

ています。これはノイズを非常に嫌う、あるいはノイズがあると困るところで使われる特別の電源です。そのため、普通の電源とは異なり、ノイズを非常に抑える設計です。市場はニッチですが、かなり技術を要する付加価値の高い製品となっています。

その他には、画像関連機器・部品やビデオ会議システムなどの情報システムの製品を扱っています。

- ・ もう 1 つの大きなセグメントは製造装置関係です。半導体の製造装置では、半導体の IC チップの製造装置もありますが、私どもは IC チップのベースになる基板を作る装置に強みを持っています。オリジナル製品もいくつかあり、材料工程で使われるプロセス装置を多く扱っています。

製造装置関係で多いのが電子部品製造装置です。こちらも自社で設計した装置を供給。現在は光半導体と言われるレーザーダイオードを使う特殊な半導体がありますが、ここに私どもの装置が多く使われており、今非常に成長している分野です。

- ・ これらのセグメント別製品の用途例について。画像機器関係や組込用の産業用 PC は製造現場のライン検査や自動化のラインで多く使われています。

もう 1 つが医療用機器です。医療用機器が手術時にノイズを拾い誤作動を起こすと、大変な事故に繋がる場合があります。そのため医療用機器は非常にノイズを嫌います。そこでノイズを抑えた電源機器が重要になります。そういう所では、私どもが自社で開発・設計、生産している超低ノイズスイッチング電源が多く使われています。

輸送用機器は主に自動車関係です。自動運転や衝突防止のセンサーなどで、ADAS (エイダス: 先進運転支援システム) には画像機器も多く使われ、私どもが供給しています。輸送用機器のもう 1 つの分野が電車です。電車には電気関係の機器をコントロールする配線が天井に多く取り付けられています。これらのハーネスを私どもで生産、供給しています。

自動化支援では、現在、色々なスーパーマーケットに自動会計システムが導入されています。そこにはカメラやモニター、レンズが使われており、そういった用途に私どもの画像機器及びレンズが使われています。

- ・ もう 1 つの用途例は半導体製造装置関係です。私どもは、チップ関係よりも基板の材料関係で自社設備等も含め供給しています。

半導体の製造工程には、材料～前工程～後工程というプロセスがあります。このうち材料のところでは私どもは強みがあり、ここに色々な製造設備を販売し、生産しています。その中でもウェーハの面取機は、今、市場で強い装置と言われており、国内のみならず海外にも輸出しています。また、後工程でも光半導体向けの設備の需要が高まっています。その需要向けに当社のスクライブ装置やブレイク装置を販売しています。それ以外のテスター関係でも色々と設計、販売しています。

- ・ 私どもはこういった半導体関連市場をターゲットとしています。今後、ハイテク絡みで成長が期待できる市場が幾つもあります。例えば、AI や IoT、5G&6G、ロボット関係

など、これらの市場向けに私どもでは色々な機器や部品、装置を供給しています。したがって、我々の今後の施策が間違いなければ、これらの市場で多く使われることになり、市場と共に成長が期待できると信じています。

2. 第11次中期経営計画【2024～2026年】

- 第11次中期経営計画は、昨年2024年から来年2026年までの3ヵ年計画です。略称を11Mといいます。11Mは長期ビジョン「2030 VISION」の中間点に当たる位置付けです。
- 「2030 VISION」で目指しているのは、当社グループの持続的な成長と持続可能な社会実現への貢献（社会のサステナビリティへの貢献）です。この目標のための中間点となるのが11Mです。
- 11Mのスローガンは「技術立社としてグローバル市場で躍進する！」です。一番のキーとなるのは、グローバルで成長しながら、売上高1,000億円を超えること。これが私どもの大方針であり、テーマだと考えています。
- そのための目標とする経営指標が3つあります。

1つ目が事業収益性です。私ども全社グループの売上総利益率20%以上を目標に掲げています。昨年末の当社の実績結果は20.2%で、現状この目標値をクリアしていますが、これを継続し、さらにもう少し上げていくことが必要だと考えています。

2つ目が財務の健全性です。目標値は自己資本比率50%を置いておりますが、現状45.1%で、総資産を圧縮し、資本の効率性を落とさず、自己資本比率を高めることを目指したいと思います。

3つ目が資本の効率性です。今一番重要視しているのがROEで、目標は12%以上ですが、今現在この数字以上にキープできている状況です。

【戦略基本方針】

- 4つの戦略基本方針があります。
- 戦略基本方針①は、事業構造の変革です。これに係る3つのKPIがあります。

1つは「安定+挑戦」の軸で、経営の安定性を目指しつつ、バランスよくビジネスを展開していきたい。私どもはエレクトロニクス関連の専門商社であり、メーカー機能も持っております。メーカー機能では、部品事業と装置事業が大きな軸になっています。これをバランスよくやっていくということです。

そして新たに、今後の成長を目指して新しい事業を作り、事業別の構成比を現状から変えて行きたいと考えています。

2つ目のKPIは「利益」軸です。当社のオリジナル製品比率を一定量持つことが非常に重要だと考えています。オリジナル製品の売上比率は25%を目標としておりますが2024年末で16.8%という状況であり、目標にはまだ少し乖離があるので、今後もしっかり詰めていく必要があると考えています。

3つ目の KPI は「成長」軸です。これまで国内で色々と成長できましたが、今後さらなる成長を目指すには、海外の市場をどれだけ取り込むかが非常に重要だと思います。そういった観点から海外の売上比率 30%を目指すことを目標としており、昨年末で 26.3%まで上がってきています。

- 戦略基本方針②は、独自性を活かした強みの最大化を図ること。これは製販一体機能の最大化を図ることと、グローバル市場がキーになると考えています。
- 戦略基本方針③は、注力領域・市場を明確化し、成長を加速すること。既存のビジネスとターゲットとしている市場をしっかりと見極めていくということです。既存のビジネスで注力していくのは、半導体関連、航空宇宙・防衛関連、データセンター関連、自動外観検査装置関連、産業機器・民生機器関連の事業です。新たに全社横断型で事業化・収益化を推進するプロジェクト (PJ) があります。これはカンパニーの枠を超え、全社横断型で取り組みます。そういった形で注目しているのが、オートモーティブ PJ、メディカル PJ、IoT PJ です。さらに今後の成長に向けた新規事業には、データセンター向けの UPS (無停電電源装置) 事業があります。これは今約 50 億円規模の事業に育っています。今後の成長のために、さらにもう 1 つ新たな事業を育成したいと思っています。そこで今我々が取り組んでいるのがソフトウェア関連のビジネスです。これは私どもで取り扱うハードウェアにソフトウェアを組み合わせるものです。例えば、画像機器関連製品や組込型のパソコン製品とソフトを組み合わせ、幅広く展開し、売上をさらに伸ばすことを始めています。
- 戦略基本方針④として、具体的な戦略を挙げていきます。その 1 つが、国内ビジネスの補強です。国内でも、まだ有望地域への取り組みが必要です。そのための新たな拠点の候補地となるのが、北海道と四国地域、三重県で検討を進めている段階です。
- 具体的な戦略には、海外ビジネスの強化もあります。現在も海外拠点は積極的に設立も含めて進めているところです。一昨年はシンガポールとオランダで事業を開始。今後も特に大きな市場であるアメリカや中国、ヨーロッパでは、今の拠点プラス出張所などを設け、点から面の展開ができる体制を作りたいと考えています。また、アジアでは、さらなる成長が期待できる中で、今はまだ拠点が無いインド地域で出張所あるいは駐在員事務所の設立を検討したいと思っています。
- グローバル生産体制の強化にも取り組んでいます。国内では生産のキャパシティアップのために、協力会社の開拓を進めています。既存の工場においても色々な補強をしながら生産能力を上げたり、新たに投資して生産能力を上げていく検討を進めています。
- 製品開発についても、今の製品群だけで大きな成長を目指すのは、将来に向けて難しい点も出てくると思われます。そこで、グローバル市場に通じる製品開発を今進めています。その中でソフトウェアとの関連も重要と考えており、自社でもソフトウェアの開発が必要になるので、関連エンジニアの補強を現在進めています。

一方、知財戦略として特許関係は、正直、弱い部分がありました。しかしこれからは知財戦略についても強化していきたいと考えています。そこで、社内の評価制度の仕組みを少し変えるなりして、特許を出しやすい環境を作り、積極的に強化していきたいと考えています。

- 事業サポート機能の強化は、管理本部を中心に展開しており、主に DX（デジタルトランスフォーメーション）の推進による生産性と業務品質の向上に取り組んでいます。また、人的資本経営による人財価値の向上をしっかりと進めたいと思います。さらに、グローバル人材の育成と国内外の人材交流を今行っています。加えて、今日のような形の広報・IR を強化し、私どものブランドの認知度を少しでも上げていきたいと考えています。
- IIM では、ESG 経営の推進にも取り組み、ガバナンスコードへの対応等を進めています。今回注目していただきたいのが、監査役会設置会社から監査等委員会設置会社への移行です。これにより取締役会の監督機能を強化し、コーポレート・ガバナンスの一層の充実を図っていきます。これについては3月28日開催予定の株主総会で承認いただくことが条件になっています。

- 資本コストや株価を意識した経営を、今後はさらに強化して進めたいと考えております。そのための指標は ROE（自己資本利益率）、PER（株価収益率）、PBR（株価純資産倍率）です。

ROE は昨年末で 14%、目標値は 12%ですので、12%をキープすることが重要ですが、それ以上できるだけ高い数字を実現していきたいと思います。

PER と PBR はこれまで、少し低いと思っていました。本日の段階では、PER で約 8 倍、PBR も 1.1 を超えるところまで来ています。この辺りの戦略は財務的なことも含め、さらに積極的に考えていく必要があると思っています。

そして最も重要なのが株主様への還元です。配当性向は、従来は 30%を目安とした方針でした。今年に入り、この目安を 40%に引き上げることを正式に決定しました。3 年計画の中で 2026 年までに 40%にしたいという方針を出していたのですが、今回正式に前倒しで、2025 年の段階で 40%に引き上げることにします。

- 2025～2026 年のキャッシュアロケーション方針について、色々な成長戦略を考える上では投資も必要になります。

まず研究開発投資は、2026 年までに 10 億円を充て、オリジナル製品の強化、開発をしっかりと進めたいと思います。新規事業では、データセンター向けの UPS 事業やソフトウェア関連を進めるために 35 億円ぐらいの投資を考えていきます。また、生産設備の新設や更新、生産キャパシティのアップも進める必要があるため、これらにもお金をかけていきます。そして DX 推進投資として、生産性や業務の改善、効率向上に向け、15 億円ほど投資します。さらに必要に応じた M&A は、事業成長のために必要なので、随

時検討していきます。

一方、株主様への還元を重要視しています。その1つとして配当性向を30%から40%に変更しています。また、自己株式の取得も今回実行しています。今後は株主様の目線を意識しながら、色々な財務対策を講じていきたいと考えています。

以上が私どもの中計についての説明です。

3. 業績ハイライト

- ・ 通期業績推移について、昨年は増収増益で終えることができました。過去最高の売上と利益を収めています。
- ・ 商品のセグメント別実績について、注目いただきたいのがオリジナル製品を含むセグメントです。総利益率をみると、電源機器を除き全て20%以上の比較的高い利益率を出しています。このことからやはりオリジナル製品の強化が重要だと考えています。
- ・ また地域別の売上比率はまだ国内が多いのですが、海外も少しずつですが、順調に伸ばしつつあります。アジア地域の比率が大きい中、北米地域が徐々に伸ばしつつあります。今後はヨーロッパやアジアを伸ばしたいと考えています。特にアジアは中国や韓国が非常に多いので、東南アジア地域のビジネスをしっかりと伸ばしたいと考えています。
- ・ 受注高の推移について、電子機器及び部品関係の受注は2023年3Qを底に、少しずつトレンドが上昇に向かっていきます。

一方、製造装置関係は投資の波の影響を受けますので、四半期ごとの変化があります。

- ・ そういった状況を加味して、受注残の状況をみると、電子機器及び部品関係は、ようやく納期の改善が進み、順調に納品できている状況です。また、少しずつ受注が回復しているので、現在の状況は私どもとして適正な受注残のレベルだと考えています。

製造装置についても同様です。ここはかなりの受注残を抱えているので、お客様へ計画通りの納入を少しずつ進め、高めの受注残のレベルをキープしたいと思います。

- ・ 今年の通期予想値については売上高で950億円、営業利益・経常利益で63.5億円、当期純利益で44億円を予想しています。
- ・ 2024年の配当は中間で55円、期末で100円、合計で155円でした。今年の配当予想は中間で70円、期末で90円、合計で160円、配当性向40.4%を目指します。
- ・ 当社は「技術へ立つ会社」ということで、ダイトロングループは、エレクトロニクス業界の技術立社として、すべてのステークホルダーとともに、グローバル市場に新たな価値を共創してまいります。どうぞ、ダイトロンをよろしくお願ひします。

4. 質疑応答

Q1. 海外、特に北米が好調ですが、今後の見通しについてお聞かせください。

A1. 私どもには北米で展開している生産工場があります。ここでは鉄道車両の天井に配さ

大和インベスター・リレーションズ(株) (以下、「当社」といいます。)はこの資料の正確性、完全性を保証するものではありません。ここに記載された意見等は当社が開催する個人投資家向け会社説明会の開催時点における当該会社側の判断を示すに過ぎず、今後予告なく変更されることがあります。当社は、ここに記載された意見等に関して、お客様の銘柄の選択・投資に対して何らの責任を負うものではありません。この資料は投資勧誘を意図するものではありません。当社の承諾なくこの資料の複製または転載を行わないようお願いいたします。

れた色々な配線（ハーネス）を生産しています。地下鉄や通勤用列車の車両向けに供給している中で、私どものお客様が大きなプロジェクトを獲得。何百両という車両の更新があり、そのハーネス需要が確定し、昨年からようやく本格的な量産が始まりました。このプロジェクトは、少なくともこの先3年間ぐらい続くプロジェクトで、場合によってはさらに次のプロジェクトも控えています。決まれば同じような規模の話が数年続く形になると思います。そういった大きなプロジェクトを獲得でき、生産が立ち上がり、量産効果を出しながら、順調に供給していることが、北米が好調な理由の1つです。それからもう1つが車載向けの関係です。私どもはADAS（エイダス：先進運転支援システム）にも関わっていますが、このシステムの画像関係の部品の供給を北米地域で始めています。これもようやく量産化されています。これは当社の生産ではなく、私どもの仕入メーカーが日本から輸出して、北米地域で販売しています。こういった安全システムの搭載が今、色々な車種に広がっています。EV車の生産台数は踊り場に入っている等言われていますが、こういった機能を搭載する車種は、どんどん増えています。そういう観点で今、車載向けの安全支援運転システムのビジネスが非常に好調です。そして、設備関係のビジネスも、北米地域で今後、大きな展開が期待できると思っています。半導体関係の設備で、シリコンやSiCなどのパワー半導体向けの新しい材料向けの加工装置やその他生産装置への投資がかなり起きると予想されます。一部では引き合いや受注もあり、受注残として2025～2026年に納入されるビジネスもあります。このような動きから今後も北米地域の成長はかなり期待できると考えています。

Q2. 半導体の分野では、トランプ大統領になって不安材料は何かあるのでしょうか。

A2. そうですね、不安はあります。正直どういう動きになるのか、なかなか読めないところがあります。

私どもは北米地域で色々なビジネスを展開しています。それから中国地域でも、結構、色々なビジネスを展開しています。この辺りがアメリカの意向により、どのように変わってくるかが、非常に気になっています。

ただ現段階では、例えば関税や輸出規制の問題での影響は出てきていません。ここ半年以内に具体的な話が出そうだという情報は、まだ私どものビジネスの中では出ていません。とにかく、予想が非常に難しい状況なのは認識しているので、しっかり注視しながら、対策を考えていきたいと思っています。

以上